

國立高雄科技大學 產學攜手合作計畫『半導體封裝產業專班』
 半導體工程系 進四技 109 學年度入學課程結構規劃表

課程類別		一年級						二年級						三年級						四年級						
		第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			
		課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	
校共同必修課程	應修學分數 10 學分	實用英文(一)	2	2	實用英文(二)	2	2	實用英文(三)	2	2																
		實務應用文	2	2	大學國語文	2	2																			
					體育(一)	0	1	體育(二)	0	1																
通識課程	博雅通識 應修學分數 10 學分 (5 大課群至 少任選 3 課 群)	美感與人文素養	博雅通識/學分數/時數																							
		科技與環境永續	博雅通識/學分數/時數																							
		社會與知識經濟	博雅通識/學分數/時數																							
		歷史與多元思維	博雅通識/學分數/時數																							
		全球與未來趨勢	博雅通識/學分數/時數																							
專業課程	必修	應修課程數 27 門/ 應修學分數 81 學分	微積分	3	3	電路學	3	3	電子學(一)	3	3	電子學(二)	3	3	半導體製程	3	3	光電元件量測 暨封裝實務	3	3	電子專題(二)	3	3	職場實習(八)	3	3
			普通物理	3	3	電路應用實務	3	3	數位邏輯實務	3	3	半導體元件	3	3	半導體量測實驗	3	3	電子專題(一)	3	3	職場實習(七)	3	3			
			普通物理實驗	3	3	半導體材料概論	3	3	微電子電路實驗	3	3	微控制器實務應用	3	3	虛擬圖控 儀表實務	3	3	職場實習(六)	3	3						
			職場實習(一)	3	3	職場實習(二)	3	3	電腦輔助電路 設計實習	3	3	職場實習(四)	3	3	職場實習(五)	3	3									
									職場實習(三)	3	3															
專業課程	選修	應修學分數 至少選修 27 學分	半導體產業介紹	3	3	統計學	3	3	半導體工業英文	3	3	光電半導體元件	3	3	太陽能光電技術	3	3	半導體 無塵室技術	3	3	感測元件 應用電路實習	3	3	自動控制	3	3
								計算機與程式應用	3	3			嵌入式系統實習	3	3	真空技術	3	3	數位系統 應用實務	3	3	數位訊號處理	3	3		
													半導體封裝工程	3	3	FPGA/HDL 設計實習	3	3	物聯網產業 介紹與應用	3	3	感測網路應用實務	3	3		
													單晶片實驗	3	3	嵌入式系統實習	3	3	半導體 負電阻元件	3	3	生醫檢測技術	3	3		
															半導體封裝工程	3	3			新穎氧化膜 製程與分析	3	3				

備註：

一、畢業總學分數為 128 學分。

二、專業課程必修 81 學分，專業課程選修 27 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)

三、校共同必修課程及通識課程 20 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。

四、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：1.承認外系選修學分 9 學分為專業選修(本院非本系開設之專業選修課程至多承認 6 學分，非本院開設之專業選修課程至多承認 3 學分)。

2.職場實習(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)，係在業界實習之課程。

